

## <<射频集成电路芯片原理与应用电路设计>>

### 图书基本信息

书名：<<射频集成电路芯片原理与应用电路设计>>

13位ISBN编号：9787505397088

10位ISBN编号：7505397087

出版时间：2004-4

出版时间：电子工业出版社

作者：黄智伟 编著

页数：308

字数：510000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<射频集成电路芯片原理与应用电路设计>>

### 内容概要

本书分为射频发射器芯片、射频接收器芯片、射频收发器芯片、无线通信射频前端芯片4个部分，介绍了最新的射频集成电路芯片的原理、结构、技术特性、应用电路和印制电路板设计。本书注重理论性与实用性的结合，注重新技术与工程性的结合，深入浅出，通俗易懂。

本书可作为从事数字视音频无线传输系统、无线遥控和遥测系统、无线数据采集系统、无线网络、无线安全防范系统等应用研究的工程技术人员，进行数字射频电路设计的参考书和工具书，也可供高等院校通信、电子等相关专业本科生和研究生参考或作为全国大学生电子设计竞赛的培训教材。

## 书籍目录

第1章 射频发射器芯片原理与应用电路设计 1.1 315 MHz ASK/FSK发射器芯片TDA5101的原理与应用电路设计 1.1.1 概述 1.1.2 主要性能指标 1.1.3 芯片封装与引脚功能 1.1.4 内部结构与工作原理 1.1.5 应用电路设计 1.1.6 315 MHz ASK发射器芯片TDA5101A 1.2 800 MHz ~ 1 GHz ASK发射器芯片MICRF103的原理与应用电路设计 1.2.1 概述 1.2.2 主要性能指标 1.2.3 芯片封装及引脚功能 1.2.4 内部结构与工作原理 1.2.5 应用电路设计 1.3 内含KEELOQ<sup>®</sup>滚动码编码器的UHF ASK/FSK发射器芯片rfHCS362G/362F的原理与应用电路设计 1.3.1 概述 1.3.2 主要性能指标 1.3.3 芯片封装与引脚功能 1.3.4 内部结构与工作原理 1.3.5 应用电路设计 1.4 230 MHz ~ 930 MHz ASK/FSK发射器芯片rfPIC12F675F/K/H的原理与应用电路设计 1.4.1 概述 1.4.2 芯片封装与引脚功能 1.4.3 内部结构与工作原理 1.4.4 应用电路设计 1.5 315 MHz ~ 433 MHz FSK/FM/ASK 发射器芯片TH7107的原理与应用电路设计 1.5.1 概述 1.5.2 主要性能指标 1.5.3 芯片封装及引脚功能 1.5.4 内部结构与工作原理 1.5.5 应用电路设计 1.6 315/433MHz ASK发射器芯片TH71071的原理与应用电路设计 1.6.1 概述 1.6.2 主要性能指标 1.6.3 芯片封装及引脚功能 1.6.4 内部结构与工作原理 1.6.5 应用电路设计 1.7 OOK/ASK 868.35 MHz 发射器芯片TX6001的原理与应用电路设计 1.7.1 概述 1.7.2 主要性能指标 1.7.3 芯片封装及引脚功能 1.7.4 芯片内部结构及工作原理 1.7.5 应用电路设计 1.8 433/868/915 MHz FM/FSK发射器芯片RF2512的原理与应用电路设计 1.8.1 概述 1.8.2 主要技术指标 1.8.3 芯片封装与引脚功能 1.8.4 内部结构与工作原理 1.8.5 应用电路设计 1.9 868 MHz/915 MHz AM/ASK/OOK发射器芯片RF2514的原理与应用电路设计 1.9.1 概述 1.9.2 主要技术指标 1.9.3 芯片封装与引脚功能 1.9.4 内部结构与工作原理 1.9.5 应用电路设计 1.10 315MHz遥控无键进入系统发射器模块DK1000T的原理与应用电路设计 1.10.1 概述 1.10.2 主要技术指标 1.10.3 模块封装与引脚功能 1.10.4 内部结构与工作原理 1.10.5 应用电路设计 1.11 310MHz ~ 440MHz ASK发射器芯片U2745的原理与应用电路设计 1.11.1 概述 1.11.2 主要性能指标 1.11.3 芯片封装与引脚功能 1.11.4 内部结构与工作原理 1.11.5 应用电路设计 1.12 310MHz ~ 330MHz ASK/FSK发射器芯片T5753的原理与应用电路设计 1.12.1 概述 1.12.2 主要性能指标 1.12.3 芯片封装与引脚功能 1.12.4 内部结构与工作原理 1.12.5 应用电路设计 第2章 射频接收器芯片原理与应用电路设计 2.1 315MHz ASK/FSK接收器芯片TDA5211的原理与应用电路设计 2.1.1 概述 2.1.2 主要性能指标 2.1.3 芯片封装与引脚功能 2.1.4 内部结构与工作原理 2.1.5 应用电路设计 2.2 800MHz~1GHz OOK接收器芯片MICRF005的原理与应用电路设计 2.2.1 概述 2.2.2 主要性能指标 2.2.3 芯片封装与引脚功能 2.2.4 芯片内部结构及工作原理 2.2.5 应用电路 2.2.6 应用例子 2.3 315/433MHz FSK/FM/ASK 接收器芯片TH71101原理与应用电路设计 2.3.1 概述 2.3.2 主要性能指标 2.3.3 芯片封装与引脚功能 2.3.4 内部结构与工作原理 2.3.5 应用电路设计 2.4 868.35 MHz OOK接收器芯片RX6501的原理与应用电路设计 2.4.1 概述 2.4.2 主要性能指标 2.4.3 芯片封装及引脚功能 2.4.4 内部结构与工作原理 2.4.5 应用电路设计 2.5 250MHz ~ 450MHz ASK接收器芯片RX3310的原理与应用电路设计 2.5.1 概述 2.5.2 主要性能指标 2.5.3 芯片封装与引脚功能 2.5.4 内部结构与工作原理 2.5.5 应用电路设计 2.6 315MHz遥控无键进入系统接收器模块DK1000R的原理与应用电路设计 2.6.1 概述 2.6.2 主要技术指标 2.6.3 模块封装与引脚功能 2.6.4 内部结构与工作原理 2.6.5 应用电路设计 2.7 300MHz ~ 450MHz ASK接收器芯片U3745BM的原理与应用电路设计 2.7.1 概述 2.7.2 主要性能指标 2.7.3 芯片封装与引脚功能 2.7.4 内部结构与工作原理 2.7.5 应用电路设计 第3章 射频收发器芯片原理与应用电路设计 3.1 300MHz ~ 500MHz无线收发芯片MICRF501的原理与应用电路设计 3.1.1 概述 3.1.2 主要性能指标 3.1.3 芯片封装与引脚功能 3.1.4 内部结构与工作原理 3.1.5 应用电路设计 3.2 300MHz ~ 930MHz FSK/FM/ASK收发器芯片 TH7120的原理与应用电路设计 3.2.1 概述 3.2.2 主要技术指标 3.2.3 芯片封装与引脚功能 3.2.4 内部结构与工作原理 3.2.5 应用电路设计 3.3 OOK/ASK 868.35 MHz收发器芯片TR1001的原理与应用电路设计 3.3.1 概述 3.3.2 主要技术指标 3.3.3 芯片封装及引脚功能 3.3.4 芯片内部结构及工作原理 3.3.5 应用电路设计 3.3.6 DR3001模块 3.4 868MHz ASK/FSK无线收发器芯片TDA 5250的原理与应用电路设计 3.4.1 概述 3.4.2 主要技术指标 3.4.3 芯片封装与引脚功能 3.4.4 内部结构与工作原理 3.4.5 应用电路设计 3.5 433/870/915MH FSK 收发器芯片XE1202的原理与应用电路设计 3.5.1 概述 3.5.2 主要技术指标 3.5.3 芯片封装与引脚功能 3.5.4 内部结构与工作原理 3.5.5 应用电路设计 3.5.6 与微控制器的接口 3.6 433MHz

## &lt;&lt;射频集成电路芯片原理与应用电路设计&gt;&gt;

FSK收发器芯片 nRF0433的原理与应用电路设计 3.6.1 概述 3.6.2 主要性能指标 3.6.3 芯片封装与引脚功能 3.6.4 内部结构与工作原理 3.6.5 应用电路设计 3.7 433/868/915MHz FSK/ASK/OOK收发器芯片RF2945的原理与应用电路设计 3.7.1 概述 3.7.2 主要技术指标 3.7.3 芯片封装与引脚功能 3.7.4 内部结构与工作原理 3.7.5 应用电路设计 3.7.6 电路设计实例 3.8 315 / 433 / 868 / 915 MHz FSK内嵌8051微控制器的收发器芯片CC1010的原理与应用电路设计 3.8.1 概述 3.8.2 主要性能指标 3.8.3 芯片封装及引脚功能 3.8.4 内部结构与工作原理 3.8.5 应用电路设计 3.9 315.00 MHz OOK收发器模块DR3101的原理与应用电路设计 3.9.1 概述 3.9.2 主要技术指标 3.9.3 芯片封装及引脚功能 3.9.4 内部结构及工作原理 3.9.5 应用电路设计 3.10 2.4GHz DSSS收发器芯片组RFW302原理与应用电路设计 3.10.1 概述 3.10.2 主要技术指标 3.10.3 芯片封装与引脚功能 3.10.4 内部结构与工作原理 3.10.5 应用电路设计 3.11 915MHz OOK收发器模块RD0300的原理与应用电路设计 3.11.1 概述 3.11.2 主要性能指标 3.11.3 内部结构与引脚功能 3.11.4 模块内部电路第4章 无线通信射频前端芯片的原理与应用电路设计 4.1 蓝牙无线收发器芯片SiW1701的原理与应用电路设计 4.1.1 概述 4.1.2 主要技术指标 4.1.3 芯片封装与引脚功能 4.1.4 内部结构与工作原理 4.1.5 应用电路设计 4.2 900MHz无绳电话射频前端芯片MAX2420/ 21/22/60/63的原理与应用电路设计 4.2.1 概述 4.2.2 主要性能指标 4.2.3 芯片封装与引脚功能 4.2.4 内部结构与工作原理 4.2.5 应用电路设计 4.3 全球定位系统GPS接收机射频芯片MAX2740的原理与应用电路设计 4.3.1 概述 4.3.2 主要技术指标 4.3.3 芯片封装与引脚功能 4.3.4 内部结构与工作原理 4.3.5 应用电路设计 4.4 数字卫星接收机 (DBS) 变频调谐器芯片MAX2102/MAX2105的原理与应用电路设计 4.4.1 概述 4.4.2 主要性能指标 4.4.3 芯片封装与引脚功能 4.4.4 内部结构与工作原理 4.4.5 应用电路设计 4.5 WCDMA与GSM900双频双模手机射频单元 4.5.1 概述 4.5.2 WCDMA/GSM双频双模手机射频单元参考设计方案的关键芯片 4.5.3 WCDMA/GSM双频双模手机射频单元参考设计方案 4.6 无线USB接口芯片CY694X的原理与应用电路设计 4.6.1 概述 4.6.2 CY694X系列芯片内部结构 4.6.3 采用CY6941的无线USB光鼠标电路 4.6.4 采用CY6942的无线USB键盘电路 4.6.5 采用CY6943和CY7C63723的USB连接器 参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>